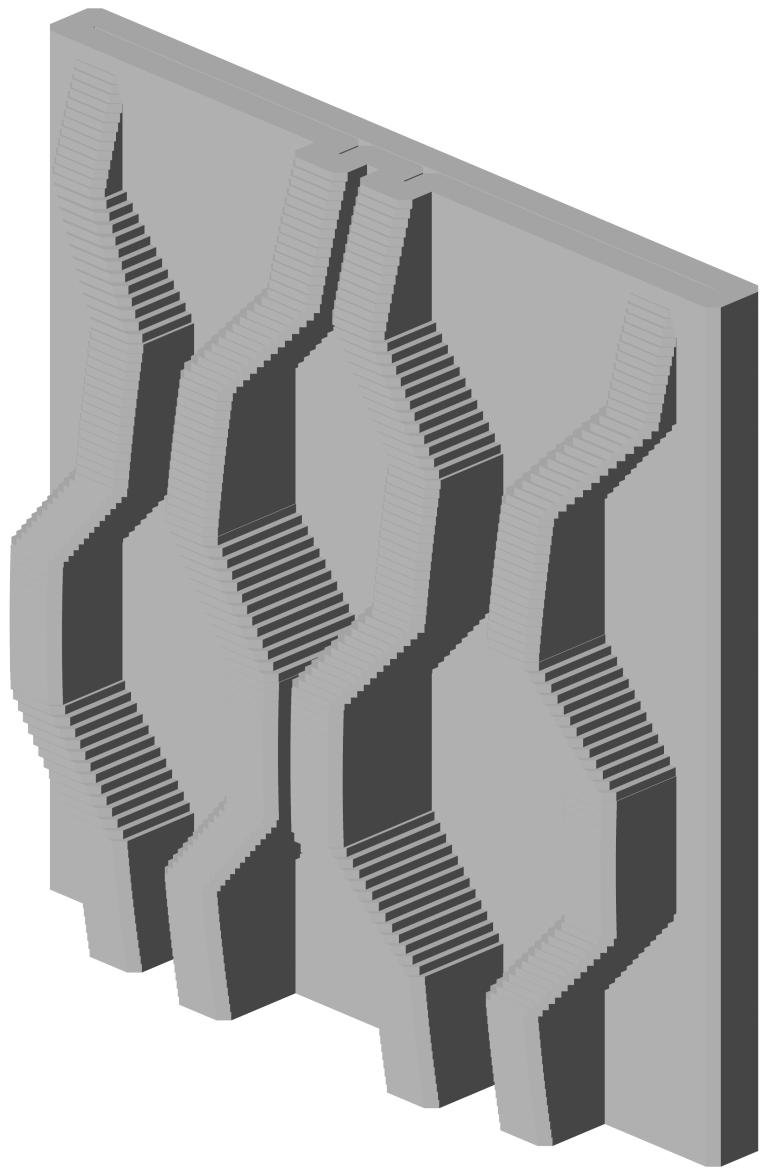
ETESIAS

D_CEM_3

Sottostruttura integrata

La superficie del pannello è caratterizzata da rilievi geometrici progettati per svolgere una funzione tecnica oltre che formale. Elementi di questo tipo possono essere utilizzati come supporto per il fissaggio di rivestimenti, componenti accessori, sistemi espositivi o ulteriori strati funzionali. La stampa 3D permette di integrare tali dispositivi direttamente nel manufatto, riducendo la necessità di sottostrutture aggiuntive.



Tecnologia: 3DCP

Volume: 0.11 mc

Materiale: Heidelberg I-Tech 3D

Lunghezza toolpath: 280.49 m

Peso: 0.23 tn

Altezza layer: 1 cm

Tempo di stampa: 25 min

N. layer: 100

Processo Parametrico

